

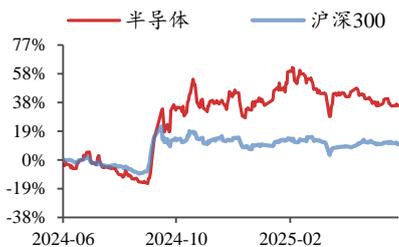
## 半导体

2025年06月23日

投资评级：看好（维持）

——行业点评报告

### 行业走势图



数据来源：聚源

### 相关研究报告

《半导体行业月度点评：下游回暖，景气度改善可期——行业点评报告》

-2025.4.27

《关税反制政策落地，模拟芯片国产化进程有望加速——行业点评报告》

-2025.4.7

《下游需求回暖+市场流动性注入，看好 SoC 板块机会——行业点评报告》

-2024.10.9

## 半导体材料跟踪点评：盛合晶微进入辅导验收阶段，关注先进封装材料投资机会

陈蓉芳（分析师）

chenrongfang@kysec.cn

证书编号：S0790524120002

陈瑜熙（分析师）

chenyuxi@kysec.cn

证书编号：S0790525020003

### ● 国产高端半导体封测龙头盛合晶微 IPO 进入辅导验收阶段

据证监会披露平台显示，盛合晶微 IPO 辅导状态变更为辅导验收。盛合晶微是国内高端半导体封测龙头，核心业务聚焦中段硅片制造和三维集成先进封装环节。据芯智讯，盛合晶微的 12 英寸高密度凸块（Bumping）加工、12 英寸硅片级尺寸封装（WLCSP）和测试（Testing）已经达到世界一流水平，目前还在进一步发展先进的三维系统集成芯片业务。2024 年 4 月，据 SEMI 引用“江阴高新区发布”公众号消息，盛合晶微三维多芯片集成封装项目、超高密度互联三维多芯片集成封装项目均为江阴市重大产业项目，项目建成后达产年将形成金属 Bump(凸块工艺)产品 8 万片/月（96 万片/年）、3DPKG（三维多芯片集成封装）产品 1.6 万片/月（19.2 万片/年）的生产能力。

### ● 解决先进封装关键材料卡脖子问题，关注本土材料国产化节奏

据 SEMI，2023 年全球半导体封测材料市场规模约 219.8 亿美元，其中包括压封装基板 55%，密封填充材料 8%，固晶材料 4%，底填材料 1%，晶圆级封装介质材料 1%等。据中国化信咨询 2023 年 5 月的研究报告，中国半导体材料整体国产化率约 15%，封装材料国产化率小于 30%。关注高端封装基板、密封填充封料、环氧塑封料原材料球形硅微粉等材料的国产化进程。

### ● 先进封装材料及相关标的梳理

- 1、电镀液：用于 RDL 工艺的表面金属化、TSV 芯片内部互联、Bumping 载板与转接板之间的互联。受益标的艾森股份、上海新阳、飞凯材料、安集科技、天承科技等。
- 2、PSPI：用于晶圆级封装中缓冲层材料及 RDL 层材料。受益标的阳谷华泰（波米科技）、艾森股份、强力新材等、
- 3、光刻胶：用于 Bumping 电镀、TSV 制造等环节。受益标的彤程新材、南大光电、晶瑞电材、上海新阳、容大感光等。
- 4、抛光材料：化学机械抛光为 TSV 工艺关键流程。受益标的安集科技（抛光液）、鼎龙股份（抛光垫）等。
- 5、掩模版：Bumping 电镀、RDL 重布线、TSV 制造、IC 封装基板/复杂中介层制造的过程中都依赖光刻技术和掩模版实现精细结构的形成。受益标的龙图光罩、清溢光电、路维光电等。
- 6、靶材：用于凸块的 UBM 和 TSV 通孔侧壁的溅射。受益标的江丰电子等。
- 7、其他：环氧塑封料受益标的华海诚科等；硅微粉受益标的联瑞新材、雅克科技等；底部填料：受益标的德邦科技等。

● 风险提示：需求不及预期、研发不及预期、产品导入/市场开拓不及预期等。

## 特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

## 分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

## 股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

## 分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

## 法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

## 开源证券研究所

### 上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层  
邮编：200120  
邮箱：research@kysec.cn

### 北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层  
邮编：100044  
邮箱：research@kysec.cn

### 深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层  
邮编：518000  
邮箱：research@kysec.cn

### 西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  
邮编：710065  
邮箱：research@kysec.cn